

EMI-TIIVISTEMASSAT

EMI-Tiiviste

PARKER CHO-BOND 4660

EMI-Gasket

- Sähköä johtavat tiivistemateriaalit
- Suunniteltu käytettäväksi sähköä johtavana gap-fillerinä tai esimerkiksi maadoittavana kotelon tiivisteenä
- Pursotettava



TUOTEKUVAUS

[Linkki valmistajan sivuille](#)

TUOTE	SELITE	KÄYTTÖKOHDDE
TECKNIT 0002	Hopeapohjainen sähköä johtava ja nopeasti kovettuva 1-komponentti silikonitiiviste	Elektroniikan koteloiden EMI-suojaukseen tai maadoittamiseen
TECKNIT 0005	Hopeapinnoitettua lasia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyolefiiniitiiviste	Suunniteltu säilyttämään joustavuus, ja tarkoitettu erityisesti kohteille jotka täytyy olla purettavissa
CHO-BOND® 4669	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyisobuteeniitiiviste	Suunniteltu erityisesti applikaatioihin joissa vaaditaan tärinänkestoa
CHO-BOND® 1016	Nikkelipinnoitettua grafiittia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Galvaanista korroosiota ehkäisevä lopputulos alumiinin kanssa
CHO-BOND® 1035	Hopeapinnoitettua lasia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Kevyt EMI-suojaus kuluttaja, ja militariapplikaatioihin
CHO-BOND® 1038	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Gap filleri EMI-suojaukseen tai maadoitukseen
CHO-BOND® 1075	Hopeapinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Erinomainen suojaus, ja galvaanista korroosiota ehkäisevä lopputulos alumiinin kanssa
CHO-BOND® 1121	VOC-vapaa hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikoni	Gap filleri EMI-suojaukseen tai maadoitukseen
CHO-BOND® 2165	Stabiloitua kuparia sisältävä sähköä johtava 2-komponentti polyuretaani	Korroosionkestävä lopputulos ilmailu ja militärikäyttöön
CHO-BOND® 4660	Hopeapinnoitettua kuparia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti polyisobuteeniitiiviste	Suunniteltu erityisesti applikaatioihin joissa vaaditaan tärinänkestoa

CHO-BOND® 1019	Hopeapinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 2-komponentti silikonitiiviste	Gap filleri/saumasaine militarikäytön EMI-suojaukseen tai elektroniikan koteloille
CHO-BOND® 1077	Nikkelipinnoitettua alumiinia sisältävä sähköä johtava 1-komponentti silikonitiiviste	Gap-filleri tai saumasaine elektroniikkakoteloiden EMI-suojaukseen
PRO-SHIELD® 7002	Nikkelipinnoitettua grafiittia sisältävä silikonitiiviste	Helppokäyttöinen gap-filleri horisontaali, ja vertikaalipinnoille
PRO-SHIELD® 7008	Hopeapohjainen silikonitiiviste	Gap-filleri applikaatioihin joissa vaaditaan maksimaalista EMI-suojasta

Löydät em. tuotteiden datalehdet sivun alareunasta Tiedostot-osiosta.

TEKNISET TIEDOT

Kovetusaika (Full)	168 h
Kovetusaika (Tack free)	1440 min
Käyttölämpötila	- 55°C to 100°C
Materiaali	Polyisobuteeni
Ominaisvastus	0.080 ohm-cm
Säilyvyys	6 kuukausi
Työaika	30 min
Täyteaine	Hopeapinnoitettu kupari
Varastointilämpötila	25°C